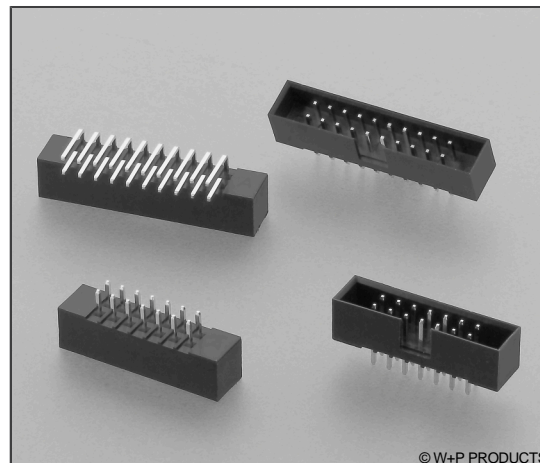


Technische Daten / Technical Data

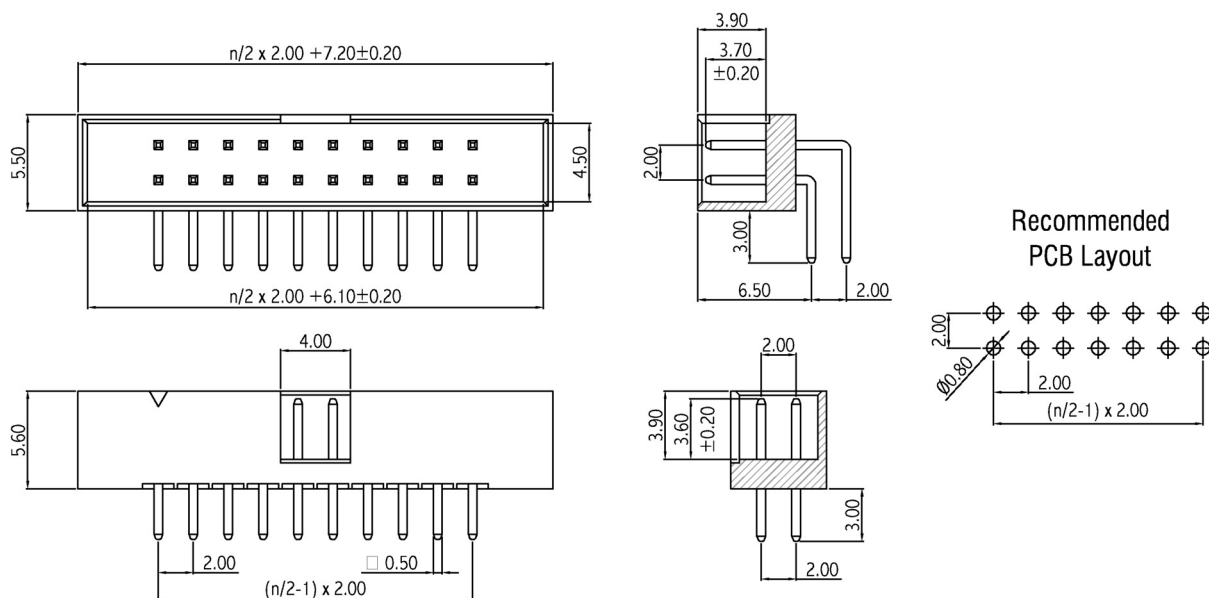
| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Isolierkörper | Thermoplast, nach UL94 V-0 |
| Insulator | Thermoplastic, rated UL94 V-0 |
| Kontaktmaterial | Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung |
| Contact Material | Square pin 0.50mm, copper alloy |
| Kontaktoberfläche | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni |
| Contact Surface | Acc. to options (see below), over Ni |
| Durchgangswiderstand | < 20 mΩ |
| Contact Resistance | < 20 mΩ |
| Isolationswiderstand | > 1000 MΩ |
| Insulation Resistance | > 1000 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500 V AC |
| Test Voltage | 500 V AC |
| Nennspannung | 125 V AC |
| Voltage Rating | 125 V AC |
| Nennstrom | 1 A |
| Current Rating | 1 A |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +105 °C |
| Temperature Range | -40 °C ... +105 °C |
| Verarbeitung | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren |
| Processing | Wave or reflow soldering |



© W+P PRODUCTS

 Passende Gegenstecker:
 Compatible Connectors:

343


Series
635
Contacts*
16

 06/08/10/12/14
 16/20/22/24/26
 30/32/34/36/40
 44/50/60/64/68

Type*
1

 1 Gerade
 Straight
 2 Gewinkelt
 Right-angled

Plating*
00

 00 Au Flash
 60 Sel. Au/Sn

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|---------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150 °C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200 °C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217 °C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260±5 °C |
| Dauer Höchsttemperatur | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P | max. 8m |

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|---------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150 °C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200 °C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60 – 180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217 °C |
| Duration above T_L | 60 – 180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3 °C / s |
| Peak Temperature T_P | 260±5 °C |
| Duration Peak Temperature | 20 – 40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6 °C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | max. 8min |

